

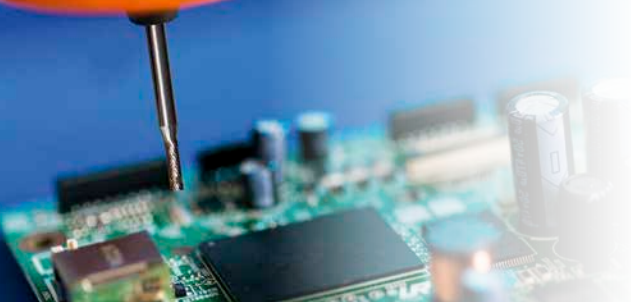
FRAISE Z DUO

- créée spécialement pour les matériaux composites combinant des couches extrêmement dures et très souples
- usinage simultané de matériaux tels que le revêtement en carbure de silicium (SiC) et de cuivre
- résout les problèmes rencontrés par les fraises conventionnelles face aux couches extrêmement dures
- avec une zone en diamant ou en CBN pour de meilleures performances
- flexibilité grâce au profilage du revêtement diamanté
- peut limiter l'encrassement provoqué par des matériaux tendres tel que le cuivre



NEXT LEVEL TOOLS.





FRAISE Z DUO

UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR L'USINAGE DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DÉCOUVREZ NOTRE DERNIÈRE INNOVATION : LA FRAISE LUKAS Z DUO

La fraise Z Duo, en instance de brevet, est le résultat d'une recherche et d'un développement approfondis visant à relever les défis de l'usinage de matériaux multicomposants avec des revêtements très durs. Grâce à son revêtement en diamant, elle est en mesure d'usiner efficacement les matériaux les plus difficiles, tels que les revêtements en carbure de silicium (SiC) et de cuivre.

Cette fraise associe dureté et précision maximales : contrairement aux fraises conventionnelles, le centre de la zone de fraisage est équipé d'un anneau CBN ou d'un revêtement diamanté. Elle permet ainsi d'usiner, en un seul passage, les matériaux composés de plusieurs couches à la fois extrêmement dures et très souples.



**DISPONIBLE SUR DEMANDE :
PARLEZ-EN À NOS COLLÈGUES
RESPONSABLES DES VENTES
OU DU DÉVELOPPEMENT.**